

引用信息: Yang Fang-Zu; Niu Zhen-Jiang; Cao Gang-Min; Xu Shu-Kai; Zhou Shao-Min. Acta Phys. -Chim. Sin., 2000, 16(11): 1022-1027 [杨防祖;牛振江;曹刚敏;许书楷;周绍民. 物理化学学报, 2000, 16(11): 1022-1027]

本期目录 | 在线预览 | 过刊浏览 | 高级检索

[打印本页] [关闭]

研究论文

镍钨磷合金电结晶机理及其镀层结构与显微硬度

杨防祖;牛振江;曹刚敏;许书楷;周绍民

厦门大学化学系, 固体表面物理化学国家重点实验室, 物理化学研究所 厦门 361005

摘要:

关键词: Ni-W-P合金 电结晶 结构 显微硬度

收稿日期 2000-02-28 修回日期 2000-06-19 网络版发布日期 2000-11-15

通讯作者: 杨防祖 Email: smzhou@xmu.edu.cn

本刊中的类似文章

Copyright © 物理化学学报

扩展功能

本文信息

[PDF\(1838KB\)](#)

服务与反馈

[把本文推荐给朋友](#)

[加入我的书架](#)

[加入引用管理器](#)

[引用本文](#)

[Email Alert](#)

[文章反馈](#)

[浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

▶ [Ni-W-P合金](#)

▶ [电结晶](#)

▶ [结构](#)

▶ [显微硬度](#)

本文作者相关文章

▶ [杨防祖](#)

▶ [牛振江](#)

▶ [曹刚敏](#)

▶ [许书楷](#)

▶ [周绍民](#)